

デュアル低電圧 理想ダイオード・コントローラ

特長

- 低損失のパワー・ダイオード代替デバイス
- Nチャネル MOSFET を制御
- 0V~18V電源のOR接続またはホールドアップ
- ゲートのターンオン時間およびターンオフ時間:1µs
- イネーブル入力
- MOSFETのオン状態出力
- 16ピンMSOPおよびDFN(4mm×3mm)パッケージ

アプリケーション

- 冗長電源
- 電源ホールドアップ
- 高可用性システムおよびサーバ
- 通信機器およびネットワークのインフラ

∠7、LT、LTC、LTM、Linear Technology、およびLinearのロゴはリニアテクノロジー社の登録商標です。Hot Swap、PowerPath およびThinSOTはリニアテクノロジー社の商標です。他の全ての商標はそれぞれの所有者に所有権があります。7920013および8022679を含む米国特許によって保護されています。

概要

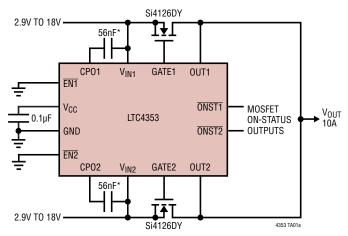
LTC®4353は、外付けのNチャネルMOSFETを制御して理想ダイオードの機能を実現します。このデバイスは、2つの大電力ショットキ・ダイオードと付随するヒートシンクを置き換え、消費電力と基板面積を節減します。理想ダイオードの機能により、低損失の電源OR接続アプリケーションや電源ホールドアップ・アプリケーションが可能です。

LTC4353はMOSFETの順方向電圧降下を調整して、ダイオードORアプリケーションで電流が滑らかに伝達されるようにします。ターンオンが高速なので、電源切り替え時での負荷の電圧低下量が減少します。入力電源が故障した場合や短絡した場合は、高速ターンオフによって逆方向電流トランジェントが最小限に抑えられます。

LTC4353 は 2.9 V \sim 18 V の電源電圧で動作します。 2 つの電源電圧が両方とも 2.9 V より低い場合は、 V_{CC} ピンに外部電源を接続することが必要です。 イネーブル入力を使用すると、 MOSFET をオフしてデバイスを低電流状態にすることができます。 状態出力は、 MOSFET がオン/オフのいずれの状態であるかを表示します。

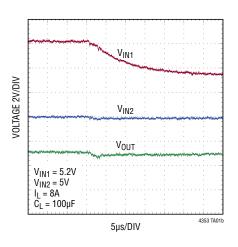
標準的応用例

2.9V~18V/10Aの理想ダイオードOR



*OPTIONAL FOR FAST TURN-ON

入力電源の障害時にも保持される出力

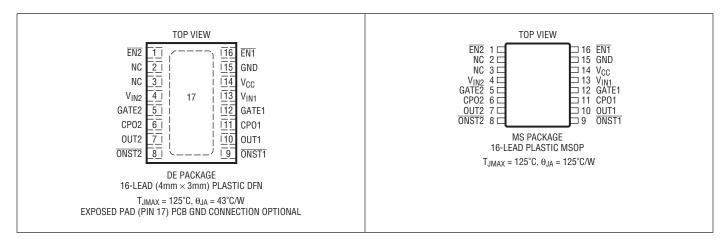


絶対最大定格 (Notes 1、2)

2 $V \sim 24V$
0.3V~6.5V
0.3V~34V
0.3V~34V
0.3V~24V
10mA
5mA

動作周囲温度範囲	
LTC4353C	0°C ~ 70°C
LTC4353I	40°C~85°C
保存温度範囲	65°C~150°C
リード温度(半田付け、10秒)	
MSパッケージ	300°C

ピン配置



発注情報

無鉛仕上げ	テープアンドリール	製品マーキング*	パッケージ	温度範囲
LTC4353CDE#PBF	LTC4353CDE#TRPBF	4353	16-Pin (4mm × 3mm) Plastic DFN	0°C to 70°C
LTC4353IDE#PBF	LTC4353IDE#TRPBF	4353	16-Pin (4mm × 3mm) Plastic DFN	-40°C to 85°C
LTC4353CMS#PBF	LTC4353CMS#TRPBF	4353	16-Pin Plastic MSOP	0°C to 70°C
LTC4353IMS#PBF	LTC4353IMS#TRPBF	4353	16-Pin Plastic MSOP	–40°C to 85°C

さらに広い動作温度範囲で規定されるデバイスについては、弊社または弊社代理店にお問い合わせください。*温度グレードは出荷時のコンテナのラベルで識別されます。 無鉛仕上げの製品マーキングの詳細については、http://www.linear-tech.co.jp/leadfree/をご覧ください。 テープアンドリールの仕様の詳細については、http://www.linear-tech.co.jp/tapeandreel/をご覧ください。



電気的特性

●は全動作温度範囲の規格値を意味する。それ以外はT_A = 25°Cでの値。注記がない限り、V_{IN1} = V_{IN2} = 12V、OUT = V_{IN}、V_{CC} はオープン。

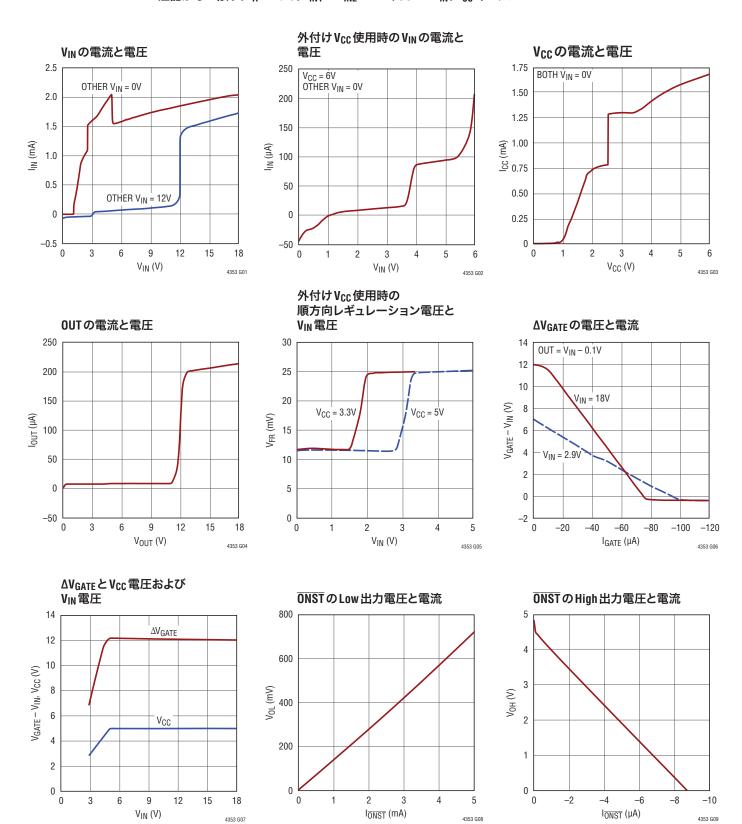
SYMBOL	PARAMETER	CONDITIONS		MIN	TYP	MAX	UNITS
電源							
V _{IN}	V _{IN1} , V _{IN2} Operating Range	With External V _{CC} Supply	•	2.9 0		18 V _{CC}	V
V _{CC(EXT)}	V _{CC} External Supply Operating Range	$V_{IN1}, V_{IN2} \leq V_{CC}$	•	2.9		6	V
V _{CC(REG)}	V _{CC} Regulated Voltage		•	4.5	5	5.5	V
lin	V _{IN1} , V _{IN2} Current Enabled, Higher Supply Enabled, Lower Supply Pull-Up Disabled	Other V_{IN} = 11.7V, Both \overline{EN} = 0V Other V_{IN} = 12.3V, Both \overline{EN} = 0V Both V_{IN} = 0V, V_{CC} = 5V, Both \overline{EN} = 0V Both \overline{EN} = 1V	•		1.5 200 –45 75	2.5 300 -80 160	mA μΑ μΑ
Icc	V _{CC} Current Enabled Disabled	V_{CC} = 5V, Both V_{IN} = 1.2V, Both \overline{EN} = 0V V_{CC} = 5V, Both V_{IN} = 1.2V, Both \overline{EN} = 1V	•		1.5 88	2.2 190	mΑ μΑ
V _{CC(UVLO)}	V _{CC} Undervoltage Lockout Threshold	V _{CC} Rising	•	2.3	2.55	2.7	V
$\Delta V_{CC(HYST)}$	V _{CC} Undervoltage Lockout Hysteresis		•	40	120	300	mV
理想ダイオー	-ド・コントローラ						
V _{FR}	Forward Regulation Voltage (V _{IN} – OUT)	V _{IN} = 1.2V, V _{CC} = 5V V _{IN} = 12V	•	2 2	12 25	25 50	mV mV
ΔV_{GATE}	MOSFET Gate Drive (GATE – V _{IN})	$\begin{array}{l} V_{FWD}=0.2V; \ I=0, \ -1\mu A; \ Highest \ V_{IN}=12V \\ V_{FWD}=0.2V; \ I=0, \ -1\mu A; \ Highest \ V_{IN}=2.9V \end{array}$	•	10 4.5	12 7	14 9	V
ton(gate)	GATE1, GATE2 Turn-On Propagation Delay	V _{FWD} (= V _{IN} – OUT) Step: – 0.3V to 0.3V	•		0.4	1	μs
t _{OFF} (GATE)	GATE1, GATE2 Turn-Off Propagation Delay	V _{FWD} Step: 0.3V to -0.3V	•		0.3	1	μs
IGATE	GATE1, GATE2 Fast Pull-Up Current GATE1, GATE2 Fast Pull-Down Current GATE1, GATE2 Off Pull-Down Current	V_{FWD} = 0.4V, ΔV_{GATE} = 0V, CP0 = 17V V_{FWD} = -0.8V, ΔV_{GATE} = 5V Corresponding \overline{EN} = 1V, ΔV_{GATE} = 2.5V	•	-0.9 0.9 65	-1.4 1.4 110	-1.9 1.9 160	Α Α μΑ
入力/出力ピ	ンの電圧						
V _{EN(TH)}	EN1, EN2 Threshold Voltage	EN Falling	•	580	600	620	mV
$\Delta V_{EN(TH)}$	EN1, EN2 Threshold Hysteresis		•	2	8	20	mV
I _{EN}	EN1, EN2 Current	At 0.6V	•		0	±1	μΑ
I _{OUT}	OUT1, OUT2 Current Enabled Disabled	OUT $n = 0V$, 12V; Both $\overline{EN} = 0V$ Both $\overline{EN} = 1V$	•	-4	8	160 16	μΑ μΑ
I _{CPO(UP)}	CPO1, CPO2 Pull-Up Current	CPO = V _{IN}	•	-40	-70	-115	μА
V _{0L}	ONST1, ONST2 Output Low Voltage	I = 1mA I = 3mA	•		0.14 0.42	0.4 1.2	V V
V _{OH}	ONST1, ONST2 Output High Voltage	$I = -1\mu A$	•	V _{CC} - 1.4	$V_{CC}-0.9$	V _{CC} - 0.5	V
IONST	ONST1, ONST2 Leakage Current	At 12V	•		0	±1	μА
$\Delta V_{GATE(ON)}$	MOSFET On-Detect Threshold (GATE – V _{IN})	ONST Pulls Low	•	0.28	0.7	1.1	V

Note 1: 絶対最大定格に記載された値を超えるストレスはデバイスに永続的損傷を与える可能性がある。絶対最大定格状態が長時間続くと、デバイスの信頼性と寿命に悪影響を与える恐れがある。

Note 2: デバイスピンに流れ込む電流はすべて正。デバイスピンから流れ出す電流はすべて負。 注記がない限り、すべての電圧はGND基準。 Note 3: 内部クランプは、GATE ピンと CPO ピンの電圧を、 V_{IN} ピンの電圧より少なくとも 10V 高い値と V_{IN} ピンの電圧よりもダイオード電圧分低い値に制限する。 これらのピンをクランプより高い電圧にドライブするとデバイスを損傷するおそれがある。



標準的性能特性 注記がない限り、TA=25°C、VIN1=VIN2=12V、OUT=VIN、VCCオープン

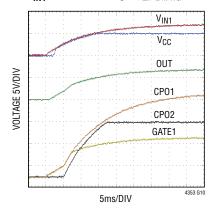


LINEAR

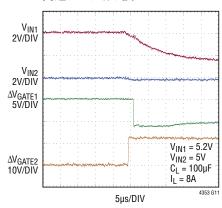
4353f

標準的性能特性 注記がない限り、TA = 25°C、VIN1 = VIN2 = 12V、OUT = VIN、VCC オープン

VIN1パワーアップ時の起動波形



障害が発生した電源からの 高速ゲート切り換え



ピン機能

CPO1、CPO2: チャージポンプの出力。このピンと対応する V_{IN} ピンの間にコンデンサを接続します。このコンデンサの容量は、MOSFETスイッチのゲート容量(C_{ISS})の約10倍とします。このコンデンサに蓄えられる電荷は、高速ターンオン時にゲートをプルアップするのに使われます。高速ターンオンが不要であれば、このピンをオープンのままにします。

ENT、EN2:イネーブル入力。対応する電源のダイオード制御を有効にするには、このピンを0.6Vより低い電圧に保持します。このピンをHighに駆動すると、MOSFETのゲートが遮断されます(ただし、遮断後もボディ・ダイオードを通して電流が流れます)。コンパレータには8mVのヒステリシスが組み込まれています。両方のENピンをHighにすると、コントローラの電流消費が低減されます。

露出パッド(DEパッケージのみ): このピンは開放のままにするか、デバイスのグランドに接続することができます。

GATE1、GATE2: MOSFET ゲート・ドライブ出力。このピンは外付けNチャネルMOSFET スイッチのゲートに接続します。内部クランプは、ゲート電圧を入力電源より12V高い値から入力電圧よりもダイオード電圧分低い値までに制限されます。高速ターンオン時は、CPOをソースとする1.4Aのプルアップ電流がGATEを充電します。高速ターンオフ時は、VINをシンクとする1.4Aのプルダウン電流がGATEを放電します。

GND:デバイスのグランド。

ONST1、ONST2: MOSFET の状態出力。GATEの電圧が V_{IN} を 0.7V を超えて上回ると、このピンは内部スイッチによってLow にプルダウンされ、MOSFET がオンであることを示します。このピンは、500k の内部抵抗によって、 V_{CC} よりもダイオード円圧 分低い電圧までプルアップされます。外部プルアップを使って V_{CC} より高い電圧にプルアップすることもできます。使用しない場合はGNDに接続するかオープンのままにします。

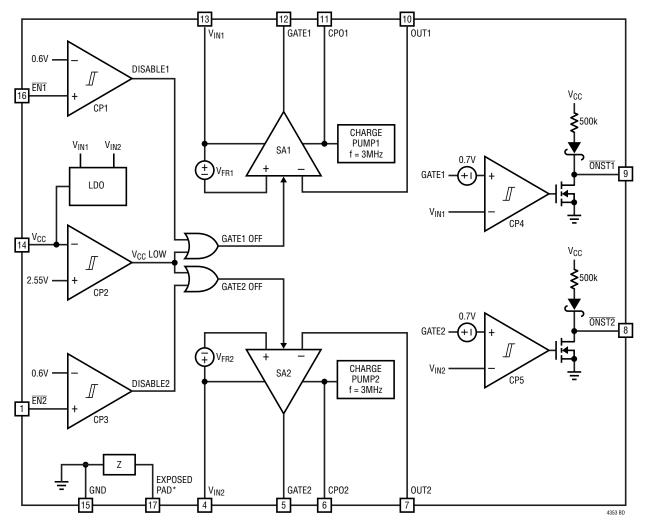
OUT1、OUT2:出力電圧センス入力。このピンはMOSFETの負荷側に接続します。このピンで検出される電圧がMOSFETのゲート制御に使われます。

 V_{CC} : 低電圧電源。このピンとグランドの間に 0.1μ Fのコンデンサを接続します。 $V_{IN} \ge 2.9$ Vの場合、このピンは5V電源を発生する内部レギュレータをデカップリングします。両方の V_{IN} が2.9Vを下回るアプリケーションでは、2.9V~6Vの範囲の外部電源電圧をこのピンに接続します。

 V_{IN1} 、 V_{IN2} :電圧センスと電源入力。このピンはMOSFETの電源入力側に接続します。低電圧電源の V_{CC} は、 V_{IN1} と V_{IN2} のいずれか高い方から発生します。このピンで検出される電圧がMOSFETのゲート制御に使われます。



機能ブロック図



*DE PACKAGE ONLY

動作

LTC4353は、NチャネルMOSFETを制御して、2つの理想ダイオードをエミュレートします。イネーブルされると、各サーボ・アンプ(SA1、SA2)は、外付けMOSFETのゲートを制御して、順方向電圧降下($V_{FWD} = V_{IN}$ -OUT)を V_{FR} にサーボ制御します。負荷電流によって電圧降下が V_{FR} よりも大きくなると、ゲート電圧が上昇し、MOSFETの導通性を高めます。出力電流が大きい場合、MOSFETのゲートは完全にオンとなり、電圧降下は、 I_{FET} ・ $R_{DS}(ON)$ に等しくなります。

MOSFETが導通しているときに入力電源が短絡すると、負荷から入力に向けて大きな逆電流が流れはじめます。このような障害が発生すると、ただちにSAが検出してゲートを高速にプルダウンし、MOSFETをオフにします。

また、大きな順方向電圧降下を検出した場合、SAは高速にゲートをプルアップします。ゲートを高速にプルアップするために、 $CPO \& V_{IN}$ ピンの間に外付けのコンデンサが必要です。このコンデンサは、デバイスのパワーアップ時に、内部チャー

ジポンプによって充電されます。蓄えられた電荷が、ゲートを 高速にプルアップするために使用されます。

GATE ピンの電流ソースはCPO ピン、電流シンクは V_{IN} および GND ピンです。GATE ピンとCPO ピンの電圧は、クランプ回路 によって V_{IN} ピンより 12V高い電圧からダイオード電圧分低い 値までに制限されます。 V_{IN} に対するGATEの電圧が0.7Vを 超えると \overline{ONST} ピンが内部スイッチによってLowにプルダウン され、MOSFET を介して電力が供給されていることを示します。

LDOは、最高の V_{IN} 入力から V_{CC} ピンに5V電源を供給する低ドロップアウト・レギュレータです。両方の V_{IN} が2.9Vを下回る場合、 V_{CC} ピンに2.9V~6Vの範囲の外部電源を接続する必要があります。

 V_{CC} と \overline{EN} ピンのコンパレータCP1~CP3が電力の導通を制御します。ENピンが0.6Vよりも高い場合、または V_{CC} ピンが2.55Vよりも低い場合は、MOSFETは常にオフ状態に保たれます。両方の \overline{EN} ピンをHighにすると、デバイスの電流消費が低減されます。



アプリケーション情報

高可用性システムでは、冗長性を持たせてシステムの信頼性を高めるために、並列接続の電源やバッテリ給電が採用されます。これらの電源を負荷に接続する一般的な方法がダイオードOR接続です。蓄電コンデンサが接続されたダイオードは、入力電圧の低下や停止時に、電源電圧を維持(ホールドアップ)します。これらの手法の欠点は、ダイオードの順方向電圧降下が大きく、これが電力損失につながることです。LTC4353は、外付けNチャネルMOSFETをパス素子として使用することで、この問題を解決します(図1参照)。電力の通過時はMOSFETがオンになるので、電源から負荷への電圧降下を小さくできます。入力電圧源が出力の共通電源電圧を下回るとMOSFETがオフになるので、理想ダイオードと同じ機能と性能が得られます。

電源構成

LTC4353 は最低 0V までの入力電源で動作可能です。このためには $2.9V \sim 6V$ の範囲の早期外部電源を使用して、 V_{CC} ピンに常に電圧を供給する必要があります。この動作範囲では、 V_{IN} が V_{CC} よりも低くなければなりません。 V_{CC} が V_{IN} よりも後に立ち上がり、内部 5V LDOから V_{CC} への逆供給が懸念される場合は、直列抵抗(数 100Ω)またはショットキ・ダイオードがデバイスの電力損失を抑え、 V_{IN} が高い間、低電圧の V_{CC} 電源に電流が逆供給されないように制限します。 V_{CC} とGND ピンの間には、デバイスの近くで 0.1μ Fのコンデンサも接続する必要があります。その接続を図2に示します。

いずれかの V_{IN} が2.9Vよりも高い場合は、 V_{CC} への外部電源接続は不要です。 0.1μ Fのコンデンサはバイパス用として引き続き必要です。

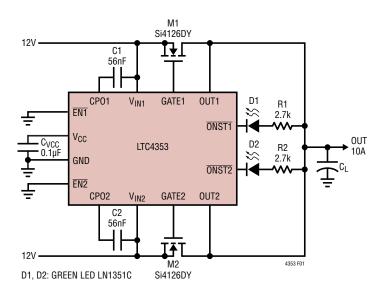


図1. ステータス・ライト付きの12V 理想ダイオード OR 接続

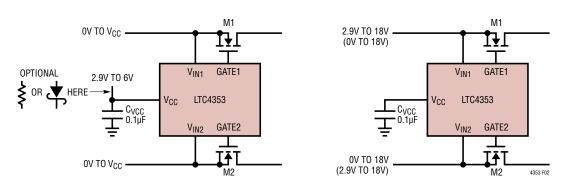


図2.電源構成



アプリケーション情報

MOSFETの選択

LTC4353 はNチャネル MOSFET を駆動して負荷電流を流します。 MOSFET の重要な特性は、最大ドレインソース電圧 BV_{DSS} 、最大ゲートソース電圧 $V_{GS(MAX)}$ 、オン抵抗 $R_{DS(ON)}$ です。

入力がグランドに接続された場合、MOSFETの両端に全電源電圧が加わる可能性があります。この電圧に耐えるため、 BV_{DSS} は電源電圧よりも高くなければなりません。MOSFETの $V_{GS}(MAX)$ 定格には14Vよりも大きい値が必要です。 V_{IN} を基準としたGATEの内部クランプ電圧の上限が、この値だからです。MOSFETの $R_{DS}(ON)$ は、最大電圧降下 $(I_L \cdot R_{DS}(ON))$ と MOSFETの電力損失 $(I_L^2 \cdot R_{DS}(ON))$ を決定します。MOSFETの最小電圧降下は、サーボ・アンプのレギュレーション電圧によって決まるため、 $R_{DS}(ON)$ をいくら小さくしても $(V_{FR}/I_L$ よりも小さくしても)、効果がない場合があることに注意してください。

CPO コンデンサの選択

CPOピンと V_{IN} ピンの間のコンデンサの推奨値は、MOSFETの入力容量(C_{ISS})のおよそ10倍です。コンデンサの容量が大きいほど、それに応じて内部チャージポンプによる充電に長い時間を要します。このコンデンサは、MOSFETのゲート容量と電荷を共有するため、容量が小さいとゲートの高速ターンオン時に電圧降下が大きくなります。

外部 CPO 電源

内部チャージポンプによるCPOコンデンサの充電、特にデバイスのパワーアップ時の充電には数ミリ秒が必要です。この時間は、CPOピンに外部電源を接続することで短縮できます。CPOと V_{IN} ピン間の内部クランプに流れる電流を制限するために、直列抵抗が必要です。CPO電源は、MOSFETのゲート駆動要件を満たすために、主入力電源の電圧よりも高くする必要があります。図3に、このような3.3V理想ダイオード・アプリケーションを示します。この回路では1kの抵抗を介して、CPOピンに12V電源が接続されています。1kの抵抗は V_{IN} ピンが接地されたときにCPOピンに流れ込む電流を制限します。8.7Vでゲートを駆動する場合(12V-3.3V)は、M1とM2にはロジック・レベルのMOSFETが適当です。

入力トランジェントに対する保護

入力と出力の容量が非常に小さい場合、電流の急激な変化によって、V_{IN}ピンとOUTピンに絶対最大定格の24Vを超える過渡変動が生じる可能性があります。OR接続アプリケーションでは、OUTピンからグランドに接続された1つのサージ・サプレッサによって、全ての入力をクランプします。サージ・サプレッサがない場合も、10μFの出力容量があれば、ほとんどのアプリケーションで24Vを超える過渡変動を防止するのに十分です。

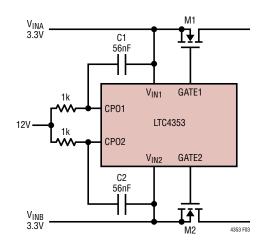


図3.起動とリフレッシュを高速化するために CPO に外部電源から 12Vを給電した3.3V 理想ダイオード



アプリケーション情報

設計例

以下の設計例では、最大負荷電流10Aの12Vシステムに使 用する部品の選定に伴う計算を示します(図1参照)。

はじめに、最大負荷時に順方向電圧降下が所望の値になるよ うなMOSFETのRDS (ON)を計算します。ここでは、VDROPを 30mV と想定します。

$$R_{DS(ON)} \le \frac{V_{DROP}}{I_{LOAD}} = \frac{30mV}{10A} = 3m\Omega$$

Si4126DYは、最大 $R_{DS(ON)}$ =2.8 $m\Omega$ 、 BV_{DSS} =30V、 $V_{GS(MAX)}$ = 20Vを、SO-8サイズのパッケージで実現した、適切なソリュー ションです。MOSFETの最大電力損失は次式で計算されます。

$$P = I^{2}LOAD \cdot RDS(ON) = (10A)^{2} \cdot 2.8m\Omega = 0.3W$$

定常状態の最大熱抵抗 θ_{JA} が35°C/W であることから、0.3W の電力損失によってSi4126DYの接合温度は周囲温度より、 さほど問題とならない11°Cしか上昇しません。

Si4126DYの入力容量C_{ISS}は約5500pFです。この値の10倍 という推奨値を採用することにして、C1とC2は56nFのコンデ ンサとします。

LEDのD1とD2で適切な輝度を得るには、約3mAで駆動す る必要があります。ダイオードの電圧降下2Vと0.6VのVoleを 考慮して、R1とR2は2.7kに設定します。

PCBレイアウトに関する検討事項

VINピンとOUTピンのトレースはMOSFETの端子にできるだ け近づけて接続します。MOSFETへのトレースは幅を広く、長 さを短くして抵抗性の損失を最小にします。MOSFETを通る 電源パスに関連するPCBトレースは抵抗を小さくします(図4 参昭)。

Vccピンのバイパス・コンデンサCvccを、VccとGNDの間に できるだけ近づけて配置することも重要です。C1とC2はCPO とVINピンの近くに配置します。サージ・サプレッサを使う場 合は、短いリード長でLTC4353の近くに実装します。

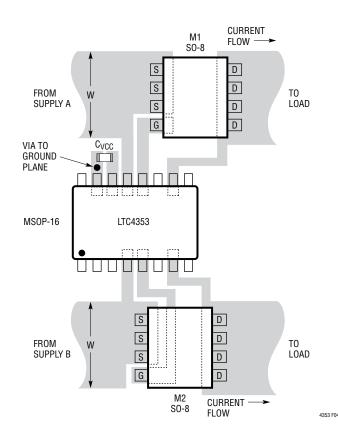


図4.M1、M2、CVCCの推奨PCBレイアウト

4353f

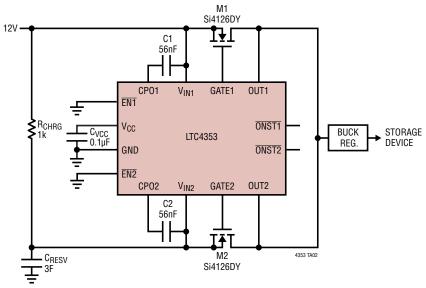
TRACK WIDTH

ON 1oz Cu FOIL

W: 0.03" PER AMPERE

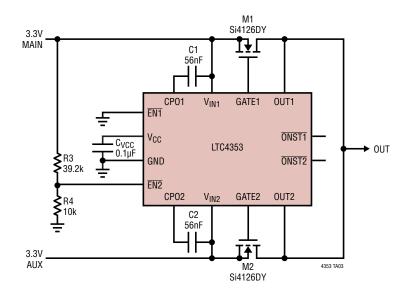
DRAWING IS NOT TO SCALE!

電源障害時のデータ・バックアップ用に蓄電容量を備えたディスク・ドライブや ソリッド・ステート・ドライブ・アプリケーション向け 12V 電源



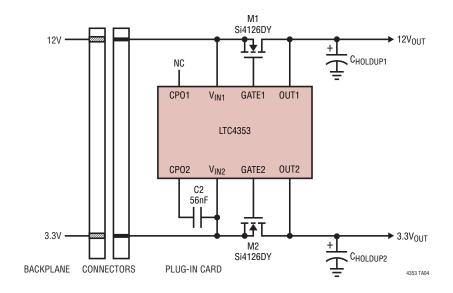
C_{RESV}: 3 PARALLEL STRINGS, EACH WITH 3 SERIES PM-5R0V305-R

3.3Vの主電源と補助電源のダイオード OR 接続(主電源電圧が2.95Vを超える場合、補助理想ダイオードは無効化されます。)

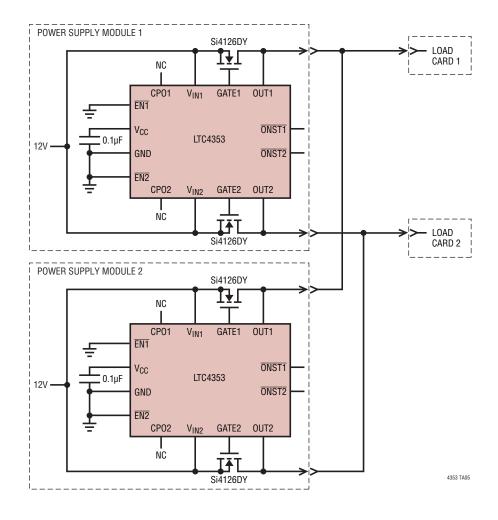




12Vと3.3Vの入力に理想ダイオードを使ったプラグイン・カードの電源ホールドアップ



MicroTCA のようにバックプレーンで OR 接続した冗長電源システム



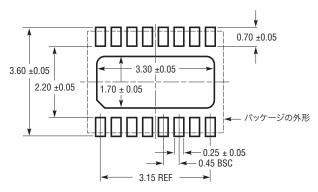


パッケージ

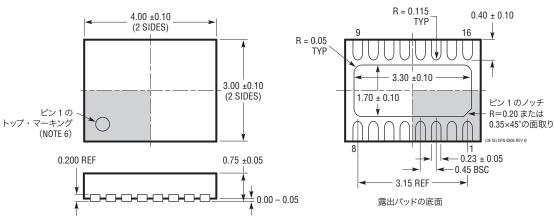
最新のパッケージ図面については、http://www.linear-tech.co.jp/designtools/packaging/を参照してください。

DEパッケージ 16ピン・プラスチックDFN(4mm×3mm)

(Reference LTC DWG # 05-08-1732 Rev Ø)



推奨する半田パッドのピッチと寸法 半田付けされない領域には半田マスクを使用する



- NOTE:
- 1. 図は JEDEC パッケージ・アウトライン MO-229 のバージョンのバリエーション (WGED-3)として提案。
- 2. 図は実寸とは異なる
- 3. 全ての寸法はミリメートル
- 4. パッケージ底面の露出パッドの寸法にはモールドのバリを含まない。
- モールドのバリは(もしあれば)各サイドで 0.15mm を超えないこと
- 5. 露出パッドは半田メッキとする
- 6. 灰色の部分はパッケージのトップとボトムのピン1の位置の参考に過ぎない

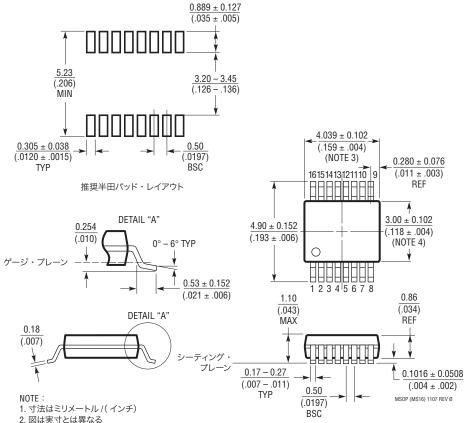


パッケージ

最新のパッケージ図面については、http://www.linear-tech.co.jp/designtools/packaging/を参照してください。

MSパッケージ 16 ピン・プラスチック MSOP

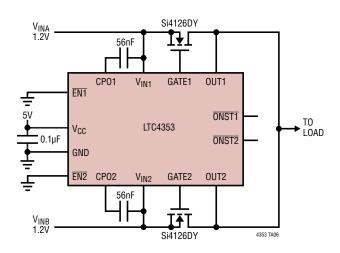
(Reference LTC DWG # 05-08-1669 Rev Ø)



- 2. 図は実寸とは異なる
- 2. 団は大いことがのパリ、突出部、またはゲートのパリを含まない モールドのパリ、突出部、またはゲートのパリな含まない。 モールドのパリ、突出部、またはゲートのパリは、各サイドで 0.152mm(0.006")を超えないこと
- 4. 寸法にはリード間のバリまたは突出部を含まない
- リード間のバリまたは突出部は各サイドで 0.152mm (0.006")を超えないこと
- 5. リードの平坦度(成形後のリードの底面) は最大 0.102mm (0.004") であること



1.2V 理想ダイオード OR 接続



関連製品

製品番号	説明	注釈
LTC1473/LTC1473L	デュアル PowerPath TMスイッチ・ドライバ	Nチャネル、4.75V~30V/3.3V~10V、SSOP-16パッケージ
LTC1479	デュアル・バッテリ・システム用 PowerPath コントローラ	3個のNチャネル・ドライバ、6V~28V、SSOP-36パッケージ
LTC4352	モニタ機能付き低電圧理想ダイオード・コントローラ	Nチャネル、OV ~ 18V、UV、OV、MSOP-12および DFN-12パッケージ
LTC4354	負電圧ダイオード OR コントローラおよびモニタ	デュアル N チャネル、-4.5V ~ -80V、SO-8 および DFN-8パッケージ
LTC4355	電源およびフューズ・モニタ付き正の 高電圧理想ダイオードOR	デュアル N チャネル、9V ~ 80V、SO-16 および DFN-14 パッケージ
LTC4357	正の高電圧理想ダイオード・コントローラ	Nチャネル、9V~80V、MSOP-8 および DFN-6 パッケージ
LTC4358	5A理想ダイオード	内部 N チャネル、9V ~ 26.5V、TSSOP-16 および DFN-14 パッケージ
LTC4370	2電源ダイオードOR電流シェアリング・コントローラ	デュアル N チャネル、0V ~ 18V、MSOP-16 および DFN-16 パッケージ
LTC4411	2.6A低損失理想ダイオード、ThinSOT™パッケージ	内部Pチャネル、2.6V~5.5V、40µA IQ、SOT-23パッケージ
LTC4412/LTC4412HV	低損失 PowerPath コントローラ、ThinSOT パッケージ	Pチャネル、2.5V ~ 28V/36V、11μA IQ、SOT-23パッケージ
LTC4413/LTC4413-1 デュアル2.6A、2.5V ~ 5.5V 理想ダイオード、 DFN-10パッケージ		デュアル内部Pチャネル、2.5V~5.5V、DFN-10パッケージ
LTC4414	大型PチャネルMOSFET用36V低損失PowerPath コントローラ	Pチャネル、3V ~ 36V、30μA I _Q 、MSOP-8パッケージ
LTC4415	電流制限を調整可能なデュアル4A理想ダイオード	デュアル P チャネル 50 m Ω 理想ダイオード、 1.7 V ~ 5.5 V、 15 mV 順方向電圧降下、 $MSOP-16$ および $DFN-16$ パッケージ
LTC4416/LTC4416-1	大型PチャネルMOSFET用36V低損失デュアル PowerPathコントローラ	デュアルPチャネル、3.6V ~ 36V、70μA I _Q 、 MSOP-10パッケージ